

上海伟测半导体科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，进一步完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，根据 2025 年上半年公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）的执行情况，公司董事会拟定了行动方案的半年度评估报告，具体如下：

一、聚焦主营业务，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者

（一）继续贯彻“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展策略，积极把握国产替代及下游战略新兴行业的发展机遇，实现公司业绩快速增长

2025 年上半年，公司继续贯彻“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展策略，聚焦高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）、高可靠性芯片（车规级、工业级）的测试需求。全球半导体市场在经历了前期的周期性调整后，随着 AIoT、工业控制、汽车电子等领域高速增长，AI 技术不断渗透和国产替代加速，2025 年上半年继续延续乐观增长走势，特别是在人工智能芯片、高算力芯片和高可靠性芯片以及部分消费电子等领域的强劲需求拉动下，公司产能利用率不断提高。公司 2025 年上半年实现营业收入 6.34 亿元，同比增长 47.53%，其中，公司第二季度实现营业收入 3.49 亿元，单季度营收创出历史新高。2025

年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,107.84 万元，较上年同期增长 831.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,371.73 万元，较上年同期增长 1,173.61%，盈利能力持续提升，经营业绩迈上新台阶。

（二）积极推进募投项目，逆周期扩大测试产能，加快南京、无锡两个测试基地的“高端芯片”和“高可靠性芯片”测试产能的建设，为公司业绩的持续增长奠定产能基础

基于对集成电路行业未来发展前景的认同，同时为满足客户日益增长的测试需求，公司自 2023 年以来积极采取前瞻性的扩张策略。2025 年上半年，公司除了推进原计划的募投项目，公司拟使用 13 亿元人民币投资伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目（二期）加码“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能建设；拟使用 9.87 亿元投资建设“伟测科技上海总部基地项目”加强公司市场竞争力和综合实力；拟使用 10 亿元在成都投资建厂扩大市场份额完善全国战略布局。截至报告期末，无锡项目和南京项目募集资金投入进度分别达到 89.19%和 97.18%。南京二期项目和成都项目尚在筹划中，上海总部基地项目已取得土地使用权。受益于行业强劲复苏、AI 相关产品深度渗透、先进封装测需求激增等原因，2025 年上半年集成电路测试需求快速增长。目前，公司在南京和无锡的募投项目均已投产且处于爬坡阶段，公司整体产能利用率整体已经达到 90%以上。

（三）继续加大研发投入力度，为公司的快速发展提供技术支撑

2025 年上半年，公司继续加大高算力芯片、车规及工业级高可靠性芯片、先进封装芯片等领域的研发力度。2025 年上半年，公司研发费用为 8,213.37 万元，较上年同期增长 27.34%，占营业收入的比重为 12.95%。截止 2025 年 6 月 30 日，公司共获得 18 个发明专利，86 个实用新型专利，85 个软件著作权。截至报告期末，公司共有 18 项在研项目，预计总投资规模 19,690 万元。

公司采取阶梯式培养研发储备人员的培养方式，持续加大研发人员培养力度。截止 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员数量 499 人，4 名核心技术人员，研发人员数量占公司总人数的 23.62%。公司始终把人才管理、人才开发和人才储备作为公司战略规划的重要组成部分，适时通过股权激励、绩效奖励等手段来加强人

才激励，不断提高全体员工的自信心、获得感，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。

（四）积极开拓市场，不断提升市场占有率

公司现有客户已经超过 200 家，不乏国内知名的集成电路设计公司，以及部分晶圆厂、封装厂及 IDM 公司，经过数年发展，公司已与广大客户建立了长期稳定的合作关系，客户基础稳固。为广泛拓展市场、深挖潜在客户，公司 2025 年 3 月积极组织主要管理人员和技术人员参与“SEMICON/FPD China 2025”与行业内人士深度交流了解行业前沿技术。2025 年上半年，公司继续大力开拓客户，公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。

二、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

2025 年上半年，公司持续强化合规治理体系建设，紧密关注法律法规和监管政策变化，严格按照中国证监会规定及《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，不断完善公司治理结构，健全内控制度，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面法律、法规及《公司章程》及其他管理制度的规定，不断规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司治理水平迈上新台阶。公司将持续致力于将治理优势转化为发展动能，推动公司治理水平不断迈上新台阶，为全体股东创造长期、稳定、可持续的价值。

公司持续完善独立董事履职保障机制，通过建立常态化沟通渠道强化独立董事与经营团队的协同效能。2025 年上半年，独立董事在公司治理中展现出深度参与和实质监督的作用。独立董事积极参加股东大会、董事会及其各专门委员会会议，结合自身专业背景，对公司对外投资方案、研发投入、关联交易、募集资金使用情况、股权激励实施情况等相关议案进行了严格审核和独立判断；定期审阅公司财务报告及内审报告，与管理层及外部审计师保持密切沟通，就关键会计政策、重大会计估计和审计发现进行质询与探讨，切实履行财务监督职责。

三、提高信息披露水平，加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

值

公司自上市以来，高度重视投资者关系工作，积极回复“上证 e 互动”平台上投资者提出的问题，在年度报告、半年度报告及季度报告披露之后，在上证路演中心举办业绩说明会，对公司各期业绩及公司的业务情况进行说明。公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，确保信息披露的及时性和公平性。2025 年上半年，公司进一步提升了信息披露的质量，并持续加强与投资者的沟通交流，具体情况如下：

（一）不断提高信息披露水平，进一步增强信息披露内容的可读性、直观性

自从上市以来，公司始终严格遵循中国证监会和上海证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，致力于保障所有股东享有平等的信息获取权利。公司采用文字、图表等多种形式相结合的方式，确保投资者能够及时了解公司的经营状况和投资价值。2025 年上半年，公司进一步提升了信息披露的质量，在 2024 年年度报告披露后，我们采用了可视化财报的形式，使投资者能够更加直观地理解公司的财务状况和业绩情况。

（二）加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

2025 年上半年，公司继续加强投资者沟通，积极传递公司投资价值，具体情况如下：

1、2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露以后，公司积极举行业绩说明会和电话会议，与投资者充分沟通公司业务情况、财务情况及公司未来发展战略。

2、2025 年上半年，公司共召开了 2 次股东大会。在股东大会上，公司董事、高级管理人员与投资者进行了良好而真诚的沟通。为方便中小投资者参与股东会，维护中小投资者参与公司治理的合法权益，公司股东大会均使用了“一键通”服务，中小投资者股东会网络投票参与度显著提升。

3、2025 年上半年，公司在上证 e 互动平台积极回复投资者的各类问题达 100 余条，通过投资者热线积极与投资者进行沟通交流，充分体现了公司对投资者权

益的尊重与保护。

四、完善投资者回报机制,继续保持不低于 30%的现金分红比率,提升公司投资价值

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司重视投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展,根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素,制定合理的利润分配方案。

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》等议案,2025 年 6 月 11 日披露《2024 年年度权益分派实施公告》。公司已于 2025 年 6 月 18 日实施完成 2024 年年度权益分派。2024 年年度权益分派方案为:“本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 114,159,795 股为基数,每股派发现金红利 0.34 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利 38,814,330.30 元,转增 34,247,938 股,本次分配后总股本为 148,407,733 股”。现金红利总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.27%

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束

1、制定与经营业绩相挂钩的高管薪酬政策

公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。公司高级管理人员的薪酬政策与公司的经营情况相挂钩。公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金和年终奖金组成,同时公司根据每月度的营业收入情况制定月度营业收入奖金。根据每月的公司经营情况,结合个人及主管部门的业务情况,确定高级管理人员的绩效奖金。绩效奖金及年终奖金均与公司业绩及个人绩效完成情况挂钩。

2、通过业绩考核强化股权激励约束机制

公司在报告期内制定了 2025 年限制性股票激励计划(草案),拟向 308 名激励对象授予了 102.10 万股的第二类限制性股票。本次限制性股票激励计划有利

于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划设置了营业收入的考核目标和个人的绩效考核，考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

2023 年、2024 年限制性股票激励计划在本报告期内已进入归属期的限制性股票已按照相应考核目标达成情况完成了股份归属登记工作。

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在有序实施中，以上内容是基于行动方案 2025 年半年度的实施情况而作出评估。在后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者的关切，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日